

Cutting Edge

第69期 事業のご報告

平成19年4月1日～平成20年3月31日

証券コード：6146



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

いろんなDISCOを 見つけて下さい。

社長インタビュー

DISCO Technology

DISCO Business

DISCO Story ⑥

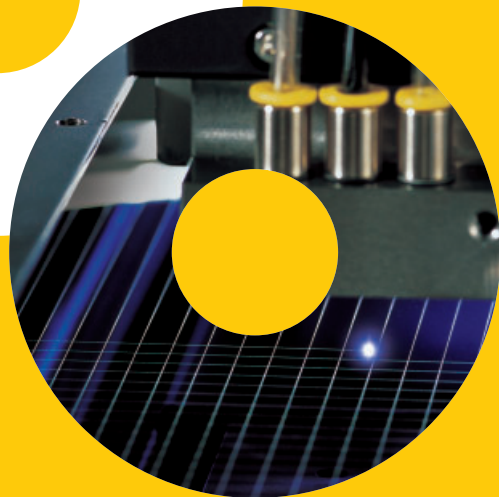
全員がゴールを共有し、確実に目標を達成する

SEMICON Japan 2007特集

BCMへの取り組み

真の成長への道標「DISCO VISION」へ





「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、
ディスコは産業と人の暮らしに
貢献しています。

高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは...

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという思いが込められているからです。

遠い科学を身近な快適につなぐとは...

科学は日々進歩しています。しかしどれほど進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

ディスコが追い求める成長とは...

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダーとの価値交換を通じ、長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

To Our Shareholders

株主の皆様へ



今後の更なる成長に向け、 先行投資を加速していきます。

2008年3月期は、先進国および新興国経済ともに安定した景気拡大を続けていましたが、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収縮により、2007年末頃から景気の減速感が強まりました。当社が主力事業を展開している半導体市場においては、メモリ製品価格の低迷で半導体メモリメーカーの収益が悪化し、設備投資抑制の動きが見られるなど、経営環境は目まぐるしく変化しました。

当社はこのような環境の中で、引き続き半導体生産に不可欠な精密加工ツール（消耗品）の需要拡大への対応をすすめるとともに、薄化やレーザ等の先端技術開発に経営資源を投入してまいりました。第3四半期の終盤以降、市況の影響によりアジア地域のサブコンを中心に投資延期などの動きも見られましたが、特にパッケージ・シングルレーション用切断装置、シリコンウェーハ向けの研削装置におい

て顧客の戦略的な設備投資が行われたことから、精密加工装置の売上は前年の売上を更新し、過去最高となりました。また精密加工ツールも半導体生産個数の増加に伴い過去最高の売上となりました。その結果、当連結会計年度の連結売上高は前年比で6.3%増の916億18百万円、経常利益は185億64百万円となりました。

一方、当社ではDISCO VISIONで定められた2010年におけるあるべき姿の実現に向け、高付加価値製品開発やCS（お客様満足）向上に注力しつつ、PIM（Performance Innovation Management）活動を通じて、あらゆる業務の進化を図っています。また、今後のさらなるグローバルな市場拡大を見据え、生産体制の拡充と継続的な成長に向けた先端技術開発への積極的な経営資源投入にも努めてまいります。

配当について

最重要施策のひとつである株主様への利益還元につきましては、4年累計の連結売上高経常利益率で20%を達成した場合は、連結配当性向20%に基づく配当に替えて、24%の配当性向を適用させていただきます。これにより年間配当は79円（中間配当35円、期末配当44円）となります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2008年6月

代表取締役社長

Contents 目次

- ② 株主の皆様へ
- ③ 社長インタビュー
- ⑤ DISCO Technology
- ⑦ DISCO Business
- ⑧ DISCO Values
- ⑨ 連結財務諸表
- ⑫ DISCO Glossary
- ⑬ 会社情報および株式の状況
- ⑭ DISCO Story... ⑥



Interview with the President

社長インタビュー



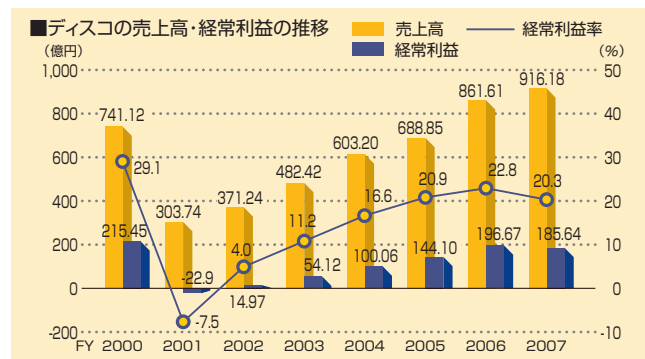
DISCOを取り巻く環境の変化と当期の業績についてお聞かせ下さい。



変化の激しい経営環境の中、さらなる顧客価値向上を図りながら過去最高の売上を記録しました。

2007年度前半は比較的安定していた世界経済動向でしたが、米国サブプライムローン問題を機に急速に減速感が強まりました。半導体業界においては、特に下期においてメモリ価格低迷の影響から、半導体メーカ各社の設備投資が抑制されました。

こうした経営環境の中、当社においては精密加工ツールは順調に販売が拡大し、精密加工装置もサブコンやメモリメーカ向けの販売は弱含んだものの、パッケージ・シンギュレーション用ダイシングエンジン、シリコンウェーハ向けグラインダなどで、顧客企業の戦略的な設備投資の実施などもあり、通期では過去最高の売上高を達成することが出来ました。



DISCO VISIONの実現に最も必要な要素は何でしょうか？

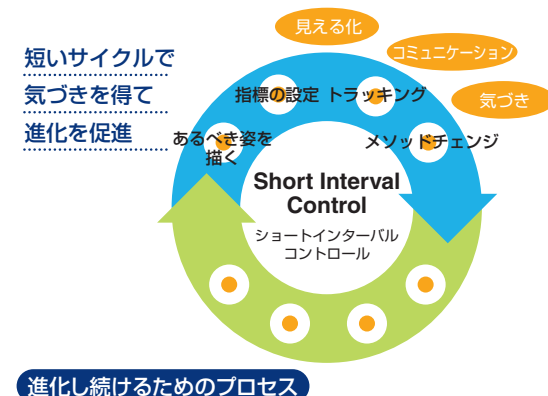


今、全員がゴールを共有し、確実に目標を達成する強い気持ちを持って努力することです。

ビジョン実現のために、各部門レベルでの推進活動が不可欠で、特に2003年に導入したPIM (Performance Innovation Management) 活動に積極的に取り組んでいます。

PIMとは業務上の目標に対して指標の設定、実行 (トラッキング)、根本的な原因の追究、方法の変更 (メソッドチェンジ) の短いサイクルを回し、組織的に気づきを得ながら進化していく手法のことです。

活動の一例として、ある装置の生産効率改善を目標に掲げたチームは、ゴールを共有し、創意工夫を重ねることで、1台の生産期間を従来の3分の1の4日にすることができました。



研究開発の基本方針と現在注力している分野をお聞かせ下さい。



コア技術における競争力維持のため、人材増強と体制の整備を推進中です。

ディスコでは、あらゆる経営資源を「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」の発展のために集中させ、積極的な研究開発を行っています。近年、戦略的に投資を行ってきた薄化技術とレーザ技術は他社にはないユニークな技術で、高いソリューション提供力を培ってきました。今後も先端技術領域における競争力を維持していくためには、研究開発体制の継続的増強が不可欠です。当期においても、総額83億円を研究開発に投入しました。

最大の注力ポイントはレーザソーの多様化するアプリケーションへの対応、ウェーハ大口径化に伴う装置大型化への対応、および試作開発スペースの拡張と将来にわたる技術者確保に向けた開発環境整備です。現在、2008年秋竣工を目処にR&Dセンター新棟を建設中です。



建設中のR&Dセンター新棟イメージ図



設備投資などの政策についてのお考えをお願いします。



お客様が安心してお使いいただけるように、BCM強化により安定生産体制を構築します。

今後も世界の需要拡大が進む中、弊社では生産力増強に努めるとともに、災害発生等緊急時における安定的供給体制の構築を目指すBCM(Business Continuity Management:事業継続管理)を推進しています。

その一環として、免震構造の建設を順次進めています。既に精密加工ツールの呉工場の新棟は昨年完成し、R&Dセンターの新棟が2008年秋に完成予定です。さらに総額125億円を投じ、精密加工装置および加工ツールの生産拠点となる桑畑工場 (広島県) と、子会社ダイイチコンポーネツの茅野工場 (長野県) に、免震構造を採用した新棟を2009年完成を目処に今夏から着工を予定しています。



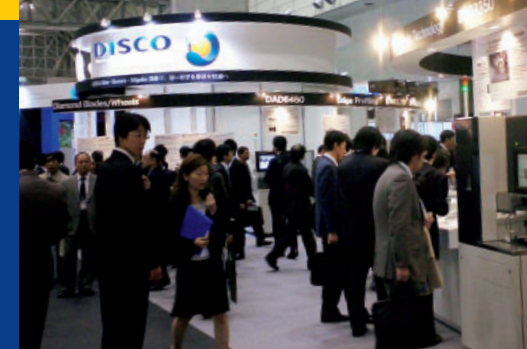
2008年夏着工予定の桑畑工場新棟イメージ図

2007年12月、 DISCOの新技术が 集結しました。

2007年12月5日～12月7日、半導体業界最大の見本市 SEMICON Japan 2007が幕張メッセにて開催されました。

ディスコは出展企業中最大規模のブースに25台の実機展示を行い、このうち新製品として精密加工装置を10台、精密加工ツールを6品種発表しました。ご来場された多くのお客様には、これらの新しい高度なKiru・Kezuru・Migaku技術を体感していただきました。

このページでは最新技術の一部についてご紹介します。



新開発レーザーソリューション

DFL7260/DFL7360/DFL7340

ダイヤモンドブレードによる精密切断に加え、ディスコでは1998年よりレーザーによる高度なKiru技術を開発してきました。今回レーザーアプリケーションの幅を大きく広げる3機種をラインナップに加えました。

DFL7260は、高輝度LEDや大容量フラッシュメモリの生産に代表されるような多彩な加工ニーズに対応できる新開発の2ヘッドレーザー装置です。2台のレーザー発振機を搭載することでアプリケーションの幅が広がりました。

浜松ホトニクス社と提携し開発したDFL7340(8inch対応)・DFL7360(300mm対応)は、新たなレーザー切断方法であるステルスダイシング技術*1)を利用し、ワーク内部に改質層*2)を形成することで、MEMS*3)デバイスやCMOSセンサ*4)などの高品位でスピーディな加工を実現します。



DFL7360

DFL7340

最先端薄化用グラインダ

DGP8761 - DFM2800

DGP8761は研削からストレスリリーフ*6)までを同一装置内にて行い、SiP*7)などの厚さ50μm以下の極薄仕上げ加工を実現する装置です。ストレスリリーフを行う3軸目には目的に応じて5種類の加工方法を選択でき、ウェーハ割れ防止に配慮した加工精度向上と高速研削による高い生産性を実現します。

DFM2800は極薄ウェーハを安全かつ高速に処理する多機能マウンタです。従来機に比べ装置内でのウェーハ持ち替え回数を5分の1に低減し、充実したクリーニング機構により、さらなる品質向上が可能になりました。

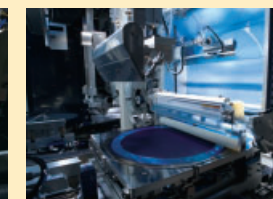
DGP8761とDFM2800を連結することで、人手の介入を出来る限り排除し、安全に次工程へウェーハを搬送します。



DGP8761-DFM2800



同一機内での研削・研磨工程



テープ貼付け機構

進化を追求した主力ダイシングソー

DFD6362

主力製品のひとつであるDFD6361をさらに進化させ、大幅な生産性向上を実現した新型フェイスングデュアル*5)ダイサです。洗浄能力強化により歩留まりの向上に寄与するほか、ブレード(刃物)間距離を従来比20%縮小し軸機構を改良することで、加工プロセスの更なる効率化を行いました。また、操作性を向上し、省スペース設計を追求しました。



加工風景



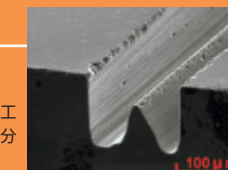
DFD6362

ユニークな発想から生まれた新型ハブブレード

ZHCRブレード

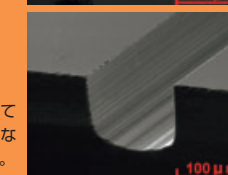
比較的厚いブレードを用いるアプリケーションでは、加工が進むにつれブレード先端の中央部のみ偏って磨耗する場合があります。このことが原因となり切りしろが広がったり、突発的な品質劣化を招くことがあります。新たに開発したハブブレード*8)ではディスコ独自の発想により、これらの問題を解決しました。

現行ブレードにて加工した溝形状。中央部分が突出している。



ZHCRブレード

ZHCRブレードにて加工した溝形状。平らな底面に改善されている。



※1～8の用語をP12で解説しています。ご参照ください。

緊急時に備えた体制作り

ディスコの製造する精密加工装置・精密加工ツールは、世界中の半導体・電子部品工場で幅広く使われています。日々生産されるこれらの製品には、当社製品が必要不可欠であり、ディスコは高いシェアを持つサプライヤ（納入業者）としての供給責任を負っています。当社は品質維持および製造ノウハウの流出を防ぐため、国内での生産にこだわっていますが、日本は地震が多く災害時に生産がストップするリスクが高いことも事実です。そのため2003年から事業継続管理^{*1} (BCM)を強化しています。

拠点ごとに被災時の緊急体制を定め、特に半導体生産に欠かせない精密加工ツールの供給体制については①在庫品の出荷（被災後3日以内）②暫定生産開始（被災後7日以内）③通常時と同じ生産体制の復旧（被災後1ヶ月以内）を目標にしています。

また地震の被害を最小限にするために免震構造の建屋の建設を進めています。2007年10月に呉工場（精密加工ツール生産拠点）において新棟が完成し、生産ラインの移管が進められています。R&Dセンター（2008年秋完成予定）、桑畑工場（精密加工装置生産拠点）および子会社ダイイチコンポーネンツ茅野工場（2009年完成予定）にもそれぞれ免震構造の新棟を建設する予定です。

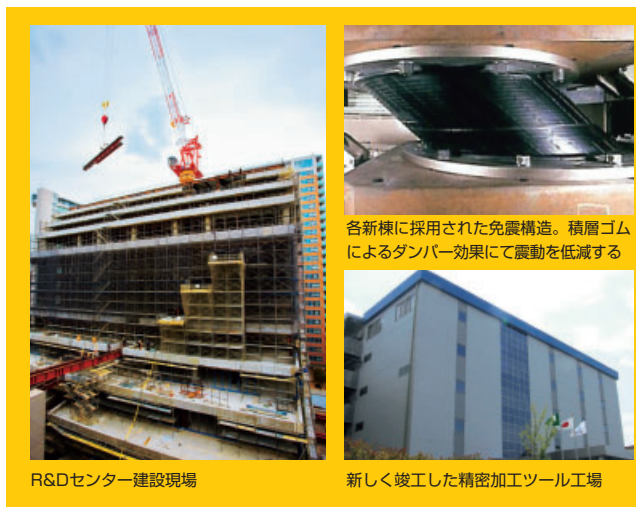
ディスコでは設備面での備えに加え、緊急避難行動の訓練も徹底して行っています。2007年度は「地震だ！逃げろ！」

プロジェクトにて、全従業員が緊急地震速報発令後に的確な退避行動が取られるよう繰り返し訓練を行いました。

さらに、役員もメンバーとして参画しているBCMコミッティが中心となり、内閣府が発表の「事業継続ガイドライン」に沿って、企業体質の強化に努めています。2008年度は英国規格協会が設けたBCMの先進的な認証規格であるBS25999-2^{*2}の取得を目指します。

^{*1} BCM : Business Continuity Management : 事業継続管理のこと。災害の発生時などに損害を最小限にし、事業活動を継続できるようにするための備えを行うことを意味します。

^{*2} BS25999-2 : 英国規格協会が事業継続管理 (BCM) を実現するための基準として2007年11月に発行。現在はBCMに関する唯一の規格です。



R&Dセンター建設現場

各新棟に採用された免震構造。積層ゴムによるダンパー効果にて震動を低減する

新しく竣工した精密加工ツール工場

従業員満足度を調査、フィードバック。社員も、家族も、誰にでも。

ディスコの考える成長とは、われわれの企業活動がミッションの実現に近づくこと、またあらゆるステークホルダーとの価値交換性の向上が図られることを通じて達成されると考えています。そのためには、株主、お客様、従業員、サプライヤ、地域社会の方々との価値交換のパイプを太くしてよりよい関係性を構築し、維持していく必要があります。

ディスコと従業員との関係において、会社が働きやすい環境や機会を提供するよう努めることで、従業員一人一人がディスコで働くことに満足し、生き生きと働いた結果として、よりよい企業活動が行われることを目指しています。



社内報別冊「ESpresso!」でES調査の結果を報告しています。

ディスコでは2003年度より、働きやすい環境を整えるため、毎年「従業員満足度調査」を実施しています。そして、全従業員約2,500人（正社員・出向社員・準社員・パートタイマー・海外駐在員含む）を調査対象とし、分析結果は社内報別冊「ESpresso!」を配布して、全員にフィードバックされます。さらに最終的な分析結果はESコミッティにて議論し、改善活動を展開しています。

また、2005年より社員が家族を招待して職場や上司、同僚を紹介する「家族見学会」を継続的に開催する等、従業員のやりがい向上に取り組んでいます。



家族見学会の様子

Financial Statements

連結財務諸表(要旨)

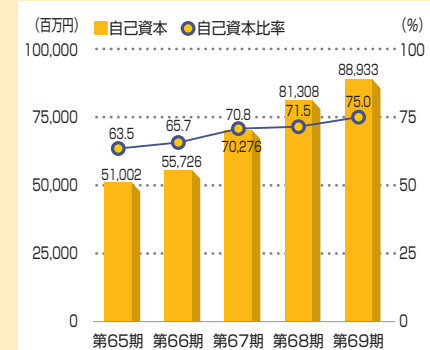


連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 科目 | 第68期通期 平成19年 3月31日現在 | 第69期通期 平成20年 3月31日現在 | 第69期中間 平成19年 9月30日現在 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 75,799 | 69,881 | 73,113 |
| 固定資産 | 37,991 | 48,772 | 44,493 |
| 有形固定資産 | 33,603 | 41,236 | 37,034 |
| 無形固定資産 | 925 | 876 | 892 |
| 投資その他の資産 | 3,462 | 6,608 | 6,565 |
| 資産合計 | 113,791 | 118,603 | 117,606 |

自己資本・自己資本比率



自己資本(純資産除く新株予約権、少数株主持分)は、76億25百万円増加しました。これは利益剰余金が83億71百万円増加したことによるものです。自己資本比率は負債が減少する一方で、純資産が増加したことにより、前年比で3.5ポイント上昇して75.0%になりました。

(単位:百万円)

| 科目 | 第68期通期 平成19年 3月31日現在 | 第69期通期 平成20年 3月31日現在 | 第69期中間 平成19年 9月30日現在 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 28,819 | 26,364 | 28,184 |
| 固定負債 | 3,148 | 2,573 | 2,747 |
| 負債合計 | 31,967 | 28,937 | 30,931 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | 80,551 | 88,770 | 85,269 |
| 資本金 | 14,485 | 14,517 | 14,510 |
| 資本剰余金 | 15,567 | 15,599 | 15,592 |
| 利益剰余金 | 50,553 | 58,924 | 55,221 |
| 自己株式 | △53 | △270 | △55 |
| 評価・換算差額等 | 755 | 161 | 791 |
| その他有価証券評価差額金 | 59 | 24 | 40 |
| 為替換算調整勘定 | 696 | 136 | 750 |
| 新株予約権 | 65 | 207 | 126 |
| 少数株主持分 | 450 | 525 | 488 |
| 純資産合計 | 81,823 | 89,665 | 86,675 |
| 負債純資産合計 | 113,791 | 118,603 | 117,606 |

ポイント 固定資産の増加

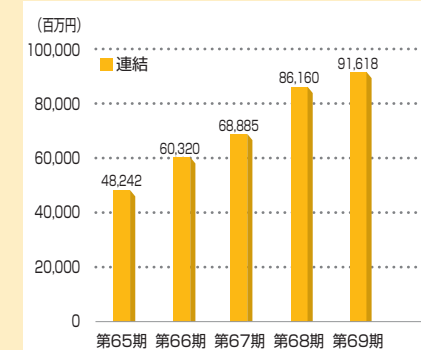
有形固定資産は前年比76億32百万円増加しました。R&Dセンター新棟建設による建設仮勘定等の増加および生産能力増強に関連した設備投資を積極的に行ったこと、また研究開発用などの装置購入等によるものです。

連結損益計算書

(単位:百万円)

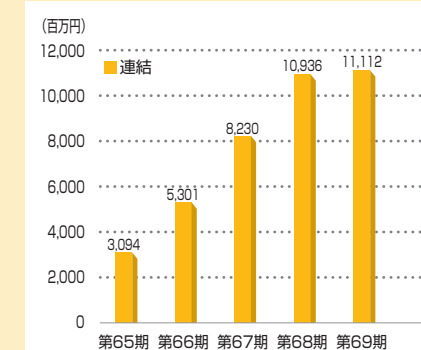
| 科目 | 第68期通期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 | 第69期通期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日 | 第69期中間 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 売上高 | 86,160 | 91,618 | 46,140 |
| 売上原価 | 42,106 | 44,757 | 22,350 |
| 売上総利益 | 44,054 | 46,860 | 23,790 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,529 | 27,526 | 12,763 |
| 営業利益 | 19,524 | 19,333 | 11,026 |
| 営業外収益 | 497 | 625 | 294 |
| 営業外費用 | 354 | 1,394 | 289 |
| 経常利益 | 19,667 | 18,564 | 11,031 |
| 特別利益 | 309 | 176 | 77 |
| 特別損失 | 2,261 | 287 | 75 |
| 税金等調整前当期(中間)純利益 | 17,715 | 18,452 | 11,033 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,450 | 6,071 | 4,029 |
| 法人税等調整額 | △720 | 1,186 | 748 |
| 少数株主利益 | 49 | 82 | 53 |
| 当期(中間)純利益 | 10,936 | 11,112 | 6,201 |

売上高



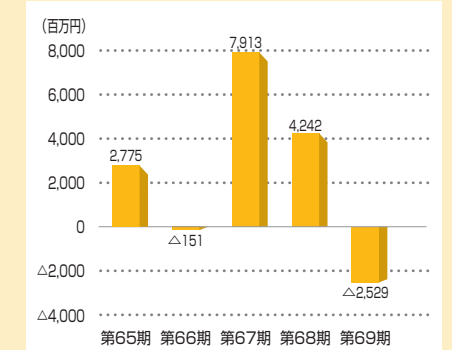
半導体および電子部品メーカーによる設備の増強により、精密加工装置ではパッケージ・シンギュレーション用や光半導体向けの切断装置、素材ウェーハ向け研削装置が売上を牽引し、また精密加工ツールも過去最高の売上高を達成し、連結売上高は前年比6.3%増加して91億618百万円となりました。

当期純利益



前年比1億76百万円の増益となりました。対売上高純利益率は12.1%となり、引き続き2桁の利益率を維持しました。前年比0.6ポイント低下しましたが、営業外費用において為替差損12億53百万円を計上したことが主な要因です。

フリーキャッシュ・フロー



出荷延期による棚卸資産の増加によって営業活動でのキャッシュ・フローが減少したことや、R&Dセンターの新棟建設と生産能力増強のための投資を活発化していることにより、営業活動と投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年比で67億71百万円減少して25億29百万円の支出超過となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科目 | 第68期通期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 | 第69期通期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日 | 第69期中間 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日 |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,194 | 9,296 | 3,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,952 | △11,825 | △6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,428 | △3,180 | △1,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | △272 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) | 2,041 | △5,982 | △4,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,003 | 24,045 | 24,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,045 | 18,062 | 19,488 |

Financial Statements

連結財務諸表(要旨)



連結株主資本等変動計算書

第69期期末(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

(単位:百万円)

| 科目 | 株主資本 | | | | | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|------------------|--------------|----------------|-------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | | |
| 平成19年3月31日 残高 | 14,485 | 15,567 | 50,553 | △53 | 80,551 | 59 | 696 | 755 | 65 | 450 | 81,823 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 32 | 32 | | | 64 | | | | | | 64 |
| 剰余金の配当 | | | △2,718 | | △2,718 | | | | | | △2,718 |
| 当期純利益 | | | 11,112 | | 11,112 | | | | | | 11,112 |
| 自己株式の取得 | | | | △217 | △217 | | | | | | △217 |
| 自己株式の処分 | | | △0 | 1 | 0 | | | | | | 0 |
| その他 | | | △23 | | △23 | | | | | | △23 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中 の変動額(純額) | | | | | | △34 | △559 | △594 | 142 | 74 | △377 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | 32 | 32 | 8,370 | △216 | 8,218 | △34 | △559 | △594 | 142 | 74 | 7,841 |
| 平成20年3月31日 残高 | 14,517 | 15,599 | 58,924 | △270 | 88,770 | 24 | 136 | 161 | 207 | 525 | 89,665 |

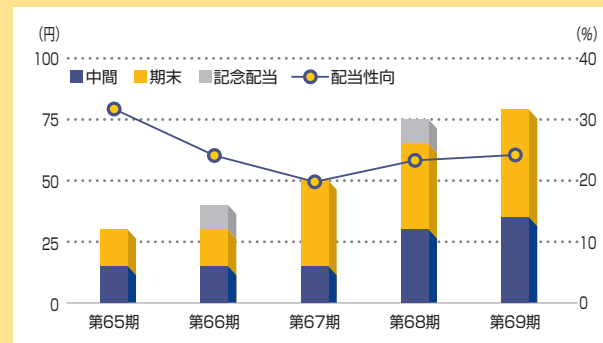
(注)平成20年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

DISCOの配当政策

平成18年2月から業績連動型の配当政策に変更し、配当性向を20%としてきましたが、平成20年3月期より連結業績において、4年累計売上高経常利益率が20%を超えた場合、20%の配当性向を24%に引き上げることといたしました。

当期の期末配当につきましては、連結での4年累計売上高経常利益率が20.4%となったため24%の配当性向を適用し、44円とさせていただきます。年間では、中間配当35円と合わせて79円とさせていただきます。

1株当たりの配当金推移



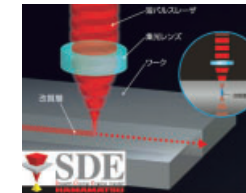
DISCO Glossary

ディスコの「用語集」



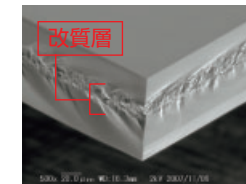
※1 ステルスダイシング技術

レーザを加工対象物(ワーク)内部に集光させ改質層(※2参照)を形成し、ワークが貼り付けてあるテープをエキスパンド(拡張)させ、改質層を起点にチップ分割をおこなうダイシング手法。ワーク内部を改質するため加工屑発生抑制や切りしろを狭くできることから、取り個数の増加に貢献できます。特にMEMSデバイス(※3参照)などの加工負荷に弱いワークの加工に適しています。



※2 改質層

レーザにより材質の組成自体を脆性化(ぜいせい化)させた帯状の箇所。



※3 MEMS

Micro Electro Mechanical Systemsの略。センサや極小モータなどの機械要素部品と電子回路を1つの基板上に集積化したデバイス。主な例としてインクジェットプリンタのヘッド、圧力センサ、加速度センサなどがあります。立体構造のため、非常に切削時の加工負荷や加工点での洗浄水の水圧に弱いので、水を使用しないレーザの加工が適しています。

※4 CMOSセンサ

光を電気信号に変えるカメラ用撮像素子。

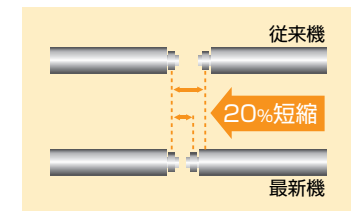
※5 フェイシングデュアル (Facing Dual)

2本のスピンドル(加工軸)が向かい合って取り付けられている機構のこと。この2本のスピンドル間距離が短ければ短いほど無駄な処理

5~6ページ『DISCO Technology』に掲載した専門用語を解説します。

時間を短縮でき、効率的な加工ができます。また、これとは別に2本のスピンドルが平行に取り付けられているものをパラレルデュアル(Parallel Dual)と呼びます。

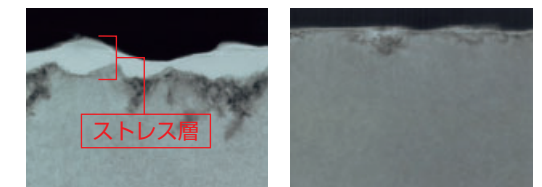
【スピンドル間距離の比較】



※6 ストレスリリーフ

研削後の加工面には微細な傷(ストレス)が存在し、ワークが薄くなればなるほどこのストレスが原因で強度が低下し、反りや割れが発生しやすくなります。これらの問題点を解消する為にストレス層を取り除き(リリーフ)、強度を向上させる工程のことをこのようにいいます。

【ワーク断面図】



ストレスリリーフ前

ストレスリリーフ後

※7 SiP

System in Packageの略。一枚一枚の半導体チップを薄くし、何枚にも積み重ね、ひとつにパッケージすることで、高性能・大容量なデバイスを製造する技術のこと。

※8 ハブブレード

ハブ部分(スピンドル軸に取り付ける基台部分)と切刃部分を一体成形した半導体切断で主流のブレード。

DISCO Information

会社情報および株式の状況



(2008年3月31日現在)

会社概要

| | |
|--------|---|
| 本社所在地 | 東京都大田区大森北二丁目13番11号 |
| 創業年月日 | 1937年5月5日 |
| 設立年月日 | 1940年3月2日 |
| 資本金 | 14,517百万円 |
| 従業員数 | 単体1,498名 連結2,260名 |
| 主な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 精密加工装置 <ul style="list-style-type: none"> 製造および販売 メンテナンスサービス オペレーションやメンテナンスの研修サービス 解体リサイクル事業 リースおよび中古品販売 精密加工ツール <ul style="list-style-type: none"> 製造および販売 精密部品の有償加工サービス |
| 事業所 | 本社・R&Dセンター 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場) |
| 国内拠点 | 仙台支店、大阪支店、九州支店 信州営業所、名古屋営業所 |

ディスコグループ関連会社

| | |
|------|---|
| 国内法人 | 株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ 株式会社ダイイチコンポーネッツ 株式会社ディーエスティー 株式会社ディーエスティー九州 株式会社KKMインベストメント |
| 海外法人 | DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD. JETSIS INTERNATIONAL PTE LTD DD Diamond Corporation TECNISCO (SuZhou) Co., Ltd DHK Solution Corporation DAA Inc. |

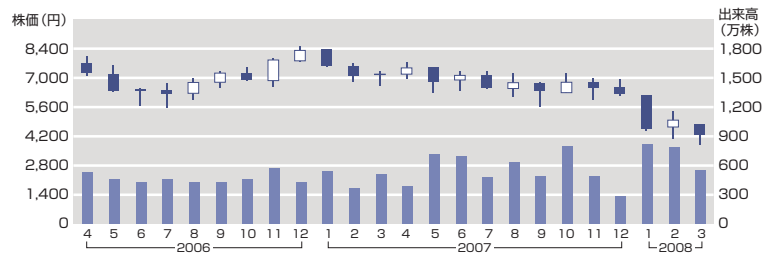
役員

| | |
|-----------|--------|
| 名誉会長 | 関家 憲一 |
| (取締役・監査役) | |
| 代表取締役社長 | 溝呂木 斉 |
| 常務取締役 | 関家 圭三 |
| | 関家 一馬 |
| 取締役 | 関家 英之 |
| | 梶山 啓一 |
| | 溝呂木 隆夫 |
| | 田村 隆夫 |
| 常勤監査役 | 玉利 晋 |
| | 高柳 忠雄 |
| 監査役 | 浅海 芳久 |
| | 黒沼 忠彦 |
| (執行役員) | 荒井 一尚 |
| | 吉永 晃 |

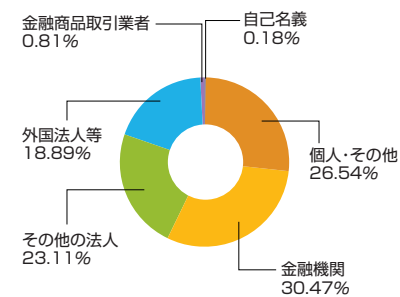
株式概要

| | |
|---------|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード6146) |
| 発行済株式総数 | 33,995,418株 |
| 株主数 | 13,812名 |
| 大株主 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) [信託口] : 3,493千株 / 10.28% 日本マスタートラスト信託銀行(株) [信託口] : 2,839千株 / 8.35% (株)ダイイチ企業 : 1,998千株 / 5.88% (株)ダイイチホールディングス : 1,998千株 / 5.88% (株)OCTAGON LAB : 1,704千株 / 5.01% 関家 憲一 : 1,338千株 / 3.94% 資産管理サービス信託銀行(株) [信託口 他] : 1,188千株 / 3.50% 関家 憲一 : 1,024千株 / 3.01% タイオウファンドエルピー : 888千株 / 2.61% (株)オレンジコーラル : 846千株 / 2.49% |

株式チャート



所有者別株式数分布状況



DISCO Story..... 6

(2001年~2007年)

【全6回シリーズ】

真の成長への道標 「DISCO VISION」へ

パソコンや携帯電話が爆発的に普及した2000年。多くの半導体・電子部品メーカは、大胆な設備投資を行い、それに伴いディスコの売上高は一気に前年の1.4倍となりました。ところが2001年に入るとIT景気は急激に失速し、過熱していた設備投資はびたりと止まってしまいました。

この年のシリコンサイクルの谷は史上最も深いものとなり、一転して業界全体が経営のスリム化、さらには業界再編を求められる状況に陥りました。そんな中、ディスコはあらゆる経費削減に取り組みながらも、6割減にもおよび売上高のダウンにより18億円の赤字を計上しました。

しかし、2001年6月に関家憲一から社長のバトンを引き継いだ溝呂木斉は、これまでにない厳しい事業環境に直面しながらも「これ以上悪くならない」という強い信念がありました。その理由は、1995年からスタートしたDFP (ディスコ・フューチャー・プロジェクト) での徹底した議論によって、経営の目指すべき方向性が明確になっていたからです。

その方向性とは、「量的な拡大ではなく、質的な向上を追求すること」。すなわち、売上高や従業員数といった規模を表す数値を大きくすることを目標とするのではなく、利益の質を表す利益率や企業活動のすべてを一級のものとすることを目標とすること。また、ミッションの実現に近づくことと会社に関わる全てのステークホルダーとの良質な価値交換が行われることが、ディスコの目指す成長であると定義していたということです。

溝呂木を中心とする経営陣は、経営の質の向上にはCS (Customer Satisfaction : お客様満足) を高めること、そしてそれを支えるES (Employee Satisfaction : 従業員満足) を高めることが必要であると確信し、2003年4月にCS憲章を



定めマネジメントシステムとして整備し、CS追求が組織的かつ継続的に可能になるようにしました。また、2004年度から従業員満足度調査を実施しより働き甲斐のある職場作りに注力しました。

加えて、在庫の増加を防ぐために、工場の生産も計画生産方式からPull生産方式 (出荷された分だけ投入される方式) へ変更。収益性の観点からは、Will会計という独自の管理会計システムを導入し、固定費や変動費以外に会社の意志で使う経費である意志費という概念を採用。収益悪化の際には意志費を削減することで利益率を確保できる体制を作りあげました。さらに2004年からは全社で構造的経費削減活動を展開し、各部門が前年度の経費の5%を削減する目標を定め4年連続で目標を達成しました。

そして2003年からはPIM (Performance Innovation Management) の導入を推進しました。PIMは各部署であるべき姿を基にした目標値を設定し、短期間で振返りを行い、改善方法などに自ら気づいていくことで組織全体の進化が行われることを目的としています。この手法は海外拠点にも導入されディスコの標準的なマネジメント手法となり、現在もVISION実現へ向け大きな推進力となっています。

1937年の創業から70年が経ち、後発の砥石メーカから様々な転進を遂げてきたディスコ。砥石による精密切断を高度化させるだけでなく、半導体の技術革新を担うレーザ技術や薄化技術などKiru・Kezuru・Migaku技術の可能性を探求していくことには変わりはありません。これからもディスコは独自の技術を通じて人々の生活をより快適にするよう企業活動のあらゆる側面の質の向上を目指し、さらなる進化を続けていきます。

株主メモ

| | |
|-------------------|--|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金 受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金 受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 基準日 | 定時株主総会については、毎年3月31日とします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (同送付先) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711 (フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店 |
| 公告方法 | 電子公告（当社のホームページに掲載します） ただしやむを得ない事由により電子公告ができないときは 日本経済新聞に掲載します。 |
| 証券コード | 6146 |

株主の皆様の声をお聞かせください

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

 <http://www.e-kabunushi.com>
アクセスコード **6146**

いいかぶ

検索

Yahoo!、MSN、exciteのサイト内にある検索窓に、いいかぶと4文字入れて検索してください。



空メールによりURL自動返信

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

- アンケート実施期間は、本書がお手元に到着後、2008年7月31日までです。

ご回答いただいた方に
薄謝(図書カード500円)
を進呈させていただきます



※本アンケートは、株式会社エーツメディアの提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。(株式会社エーツメディアについての詳細 <http://www.a2media.co.jp>) ※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただきます。事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

- アンケートのお問い合わせ TEL:03-5777-3900 (平日 10:00~17:30)
「e-株主リサーチ事務局」 MAIL:info@e-kabunushi.com

“Cutting Edge” とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほか、「最先端」という意味があります。ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解頂くために、常に最先端の技術を提供することを通じて、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしくお願いたします。

お知らせ

○配当金のお受取方法について

振込口座をご指定されておられない株主様には従来、「郵便振替支払通知書」にて配当金をお受取り頂いておりましたが、平成19年10月1日に日本郵政公社が民営化されたことに伴い、「郵便振替支払通知書」に代わって「配当金領収証」にて配当金をお受取り頂くこととなりました(従来の通り、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて配当金をお受取りできます)。

DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



株式会社 ディスコ

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11
<http://www.disco.co.jp/>



再生紙を使用しています。